TOWA 株式会社

2027 年 3 月期第 2 四半期決算説明会

2026 年 11 月 6 日

イベント概要

[企業名]	TOWA 株式会社
[企業 ID]	6315
[イベント言語]	JPN
[イベント種類]	決算説明会
[イベント名]	2027 年 3 月期第 2 四半期決算説明会
[決算期]	2027 年度　第 2 四半期
[日程]	2026 年 11 月 6 日
[ページ数]	28
[時間]	16:30 – 17:26 （合計：56 分、登壇：17 分、質疑応答：39 分）
[開催場所]	インターネット配信
[会場面積]	
[出席人数]	100 名
[登壇者]	2 名 取締役社長執行役員　三浦　宗男（以下、三浦） 取締役執行役員 経営企画本部長　中西　和彦（以下、中西）

登壇

司会：定刻となりましたので、ただいまより TOWA 株式会社 2027 年 3 月期第 2 四半期決算説明会を開催いたします。

本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございます。なお、本日の説明会につきましては、質疑応答を含む全文を書き起こし、公開する予定です。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

最初に、本日のスピーカー2 名をご紹介いたします。

取締役社長、三浦宗男でございます。取締役執行役員経営企画本部長、中西和彦でございます。

本日は、初めに中西より決算概要についてご説明させていただき、続いて三浦より事業環境および業績予想についてご説明させていただきます。その後、質疑応答の時間を設けております。

それでは初めに決算概要について中西よりご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。



中西：それでは、連結決算概要についてご説明申し上げます。

まず、第 2 四半期の連結業績です。

受注高は 329.7 億円となり、前四半期比 51.2%増、前年同期比 125.8%増となりました。生成 AI 関連に加え、データセンター向けサーバーの電源管理用途など幅広い分野で設備投資が拡大したことで、第 1 四半期に続き、四半期として過去最高を更新しました。

売上高は 175.3 億円で、前四半期比 8.3%増、前年同期比 14.1%増となりました。高水準の受注残を着実に売上へ繋げたことで増収となりました。

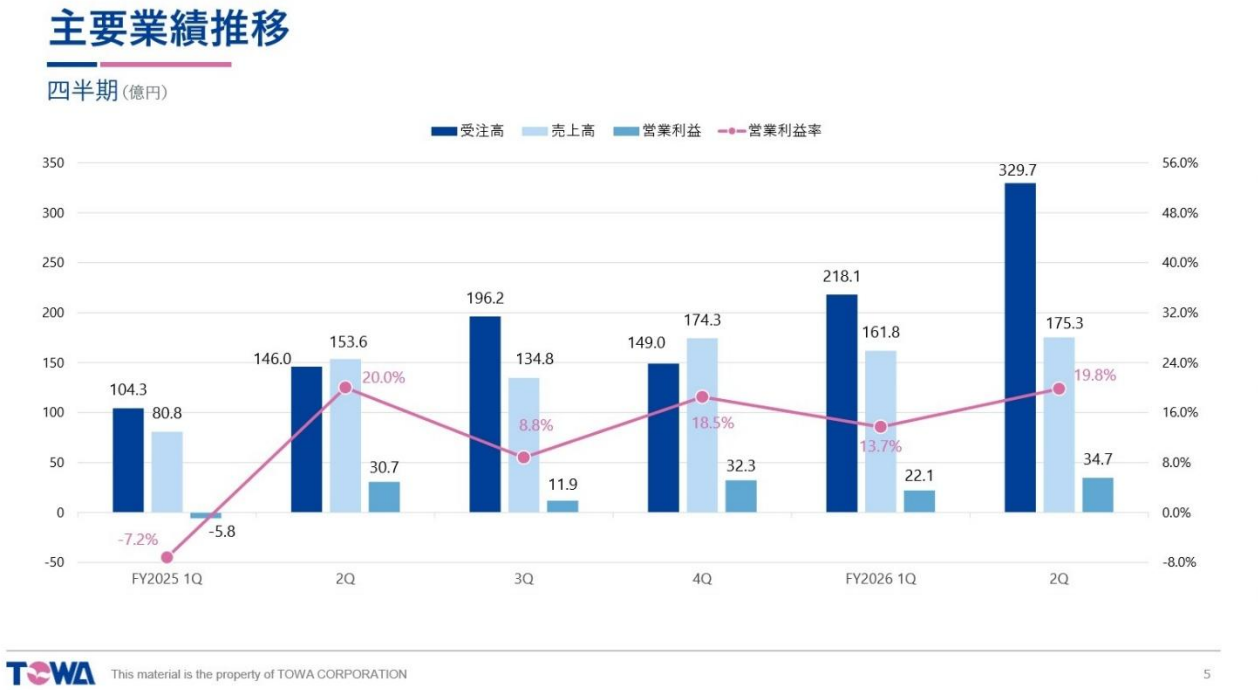
営業利益は 34.7 億円、営業利益率は 19.8%です。増収効果により、前四半期比で大幅な増益となり、利益率も 6.1 ポイント改善しました。経常利益は 29.4 億円、親会社株主に帰属する当期純利益は 21.7 億円となりました。



続いて、上期累計の連結業績です。

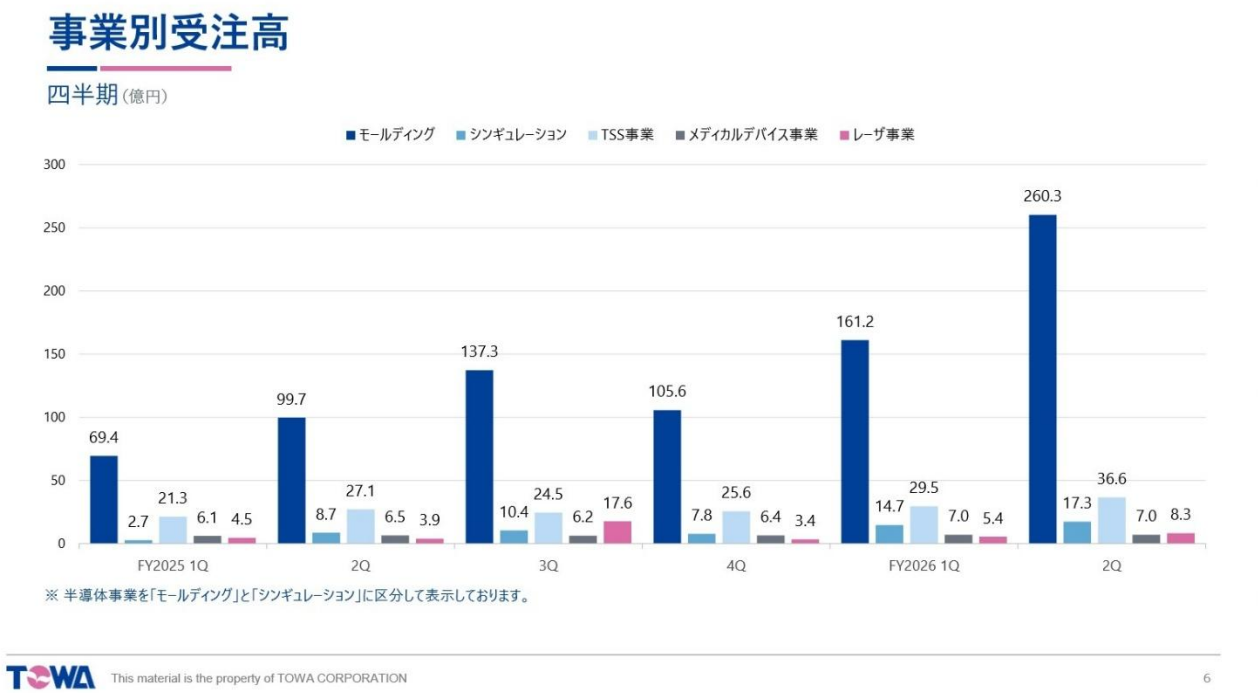
受注高は 547.8 億円で、前年同期比 118.8%増となり、半期として過去最高を更新しました。売上高は 337.1 億円で、前年同期比 43.8%増となり、こちらも半期として過去最高となりました。半導体事業では、主力のモールディング売上が 243.3 億円と大きく伸長しています。

営業利益は 56.8 億円、営業利益率は 16.9%となりました。前年同期比では 31.9 億円の増益、利益率は 6.3 ポイント改善しています。経常利益は 52.8 億円。親会社株主に帰属する当期純利益は 38.3 億円となりました。



続いて主要業績の四半期推移です。

受注高・売上高ともに回復基調が続いており、営業利益率も改善しています。受注高については、第１四半期に続き、四半期として過去最高を更新しました。



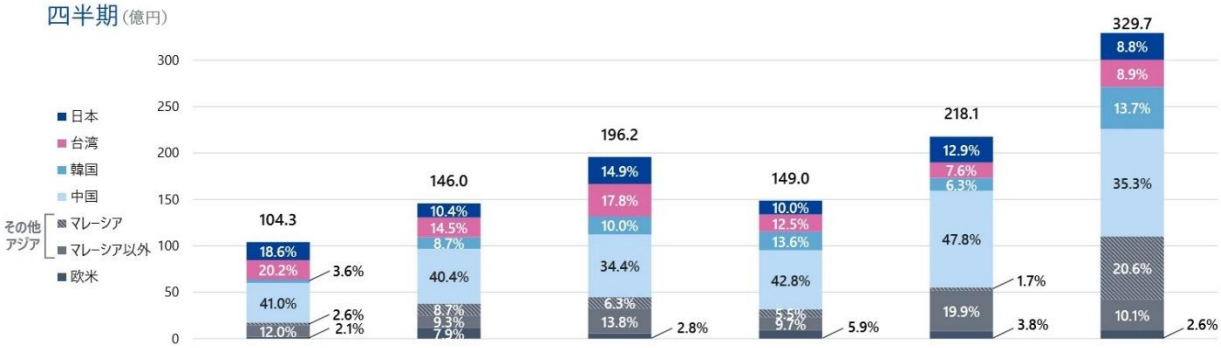
続いて事業別の受注高です。

第 2 四半期のモールディング受注は 260.3 億円となり、全体の受注拡大を牽引しました。生成 AI 向けの先端ロジック、メモリ関連に加え、データセンター向けサーバーの電源管理用途などで需要が拡大しています。

シンギュレーションは 17.3 億円、TSS 事業は 36.6 億円となり、いずれも前四半期を上回りました。TSS 事業は、お客様の設備稼働率の改善を背景に、消耗品やアフターサービスなどの需要が増加しています。

地域(出荷先)別受注高

四半期(億円)



	FY2025 1Q	2Q	3Q	4Q	FY2026 1Q	2Q
日本	19.3	15.2	29.2	14.8	28.0	29.0
台湾	21.0	21.2	34.8	18.5	16.6	29.2
韓国	3.7	12.6	19.5	20.2	13.8	45.1
中国	42.7	59.0	67.4	63.8	104.1	116.2
その他アジア	15.2	26.3	39.5	22.6	47.1	101.2
うちマレーシア	2.7	12.7	12.4	8.1	3.6	67.8
うちマレーシア以外	12.5	13.6	27.0	14.5	43.4	33.4
欧米	2.1	11.5	5.5	8.8	8.2	8.7
合計	**104.3**	**146.0**	**196.2**	**149.0**	**218.1**	**329.7**

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

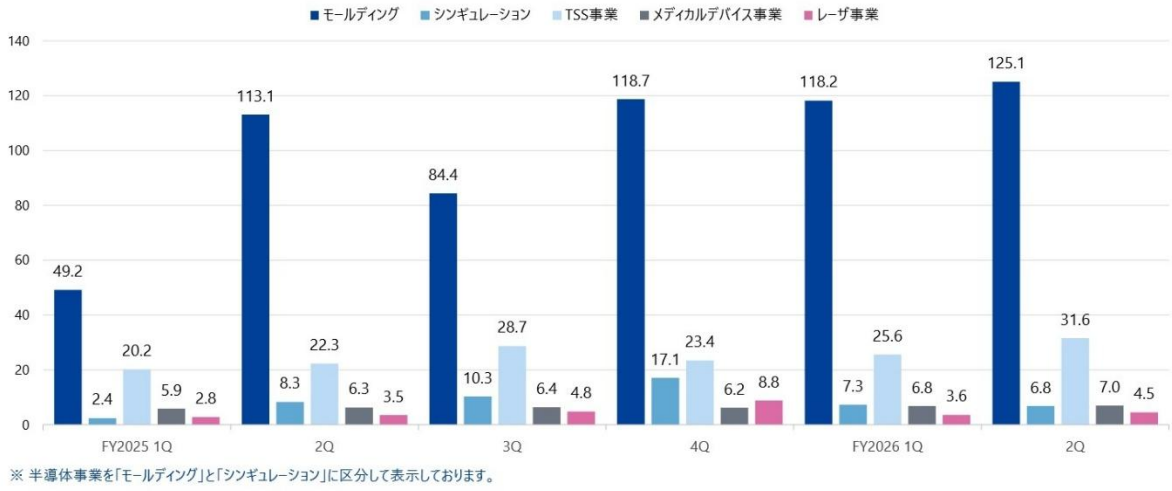
続いて出荷先ベースの地域別受注高です。

第 2 四半期は中国が 116.2 億円、その他アジアが 101.2 億円、韓国が 45.1 億円となり、アジア各地域で受注が大きく増加しました。

中国では引き続き半導体内製化に向けた投資が好調です。台湾・韓国では生成 AI 需要を背景としたメモリ関連投資が活発化しました。その他アジアでは、マレーシアを中心にアナログ半導体やパワー半導体向け投資が寄与しました。

事業別売上高

四半期（億円）



※ 半導体事業を「モールディング」と「シンギュレーション」に区分して表示しております。

This material is the property of TOWA CORPORATION

続いて事業別の売上高です。

第 2 四半期のモールディング売上は 125.1 億円となり、前四半期および前年同期を上回りました。高水準の受注残を順次売上へ繋げています。TSS 事業は 31.6 億円となり、装置納入台数の増加やお客様設備の稼働に伴う消耗品やアフターサービス需要が寄与しました。メディカルデバイス事業は 7.0 億円、レーザ事業は 4.5 億円となり、いずれも前年同期を上回りました。

地域(出荷先)別売上高

四半期（億円）



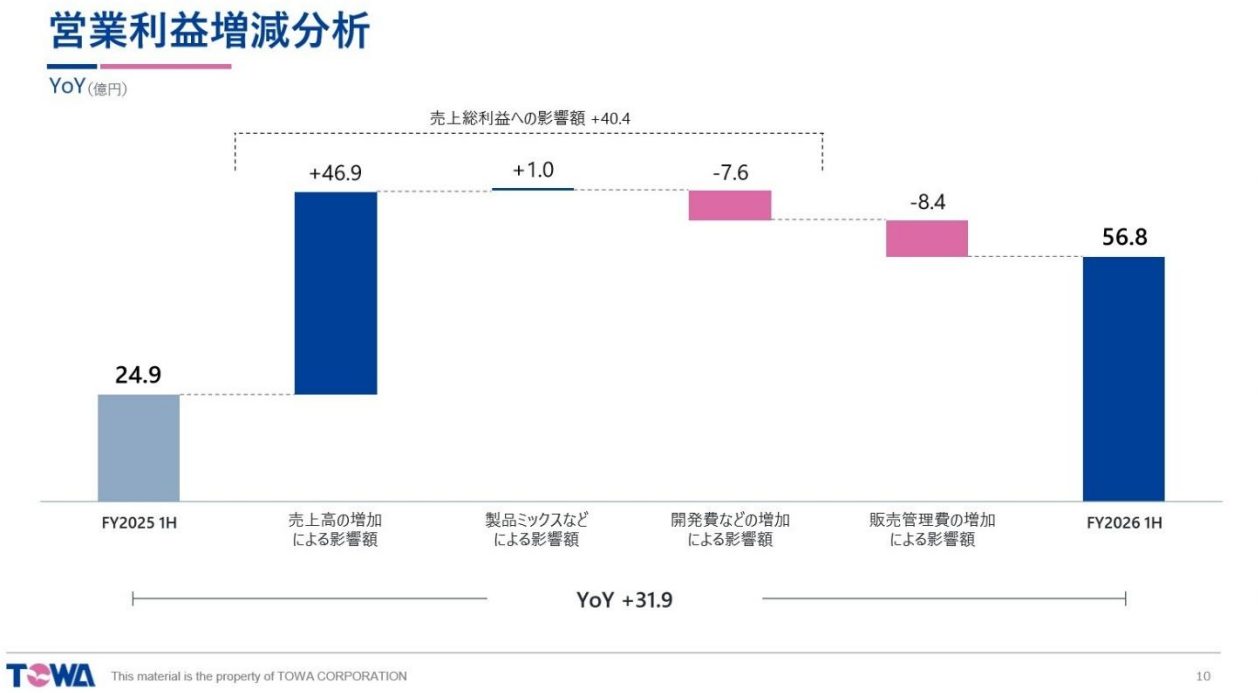
	FY2025 1Q	2Q	3Q	4Q	FY2026 1Q	2Q
日本	13.7	15.5	16.9	22.9	19.9	19.6
台湾	17.5	20.6	17.5	16.5	23.3	20.1
韓国	7.0	15.3	13.4	13.3	27.0	16.2
中国	27.9	61.2	59.9	73.0	56.0	82.8
その他アジア	10.1	36.9	18.6	38.4	29.1	22.3
うちマレーシア	2.8	16.4	3.2	15.7	9.7	10.1
うちマレーシア以外	7.2	20.5	15.4	22.7	19.4	12.1
欧米	4.4	3.8	8.3	9.9	6.2	14.0
合計	**80.8**	**153.6**	**134.8**	**174.3**	**161.8**	**175.3**

This material is the property of TOWA CORPORATION

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

続いて出荷先ベースの地域別売上高です。

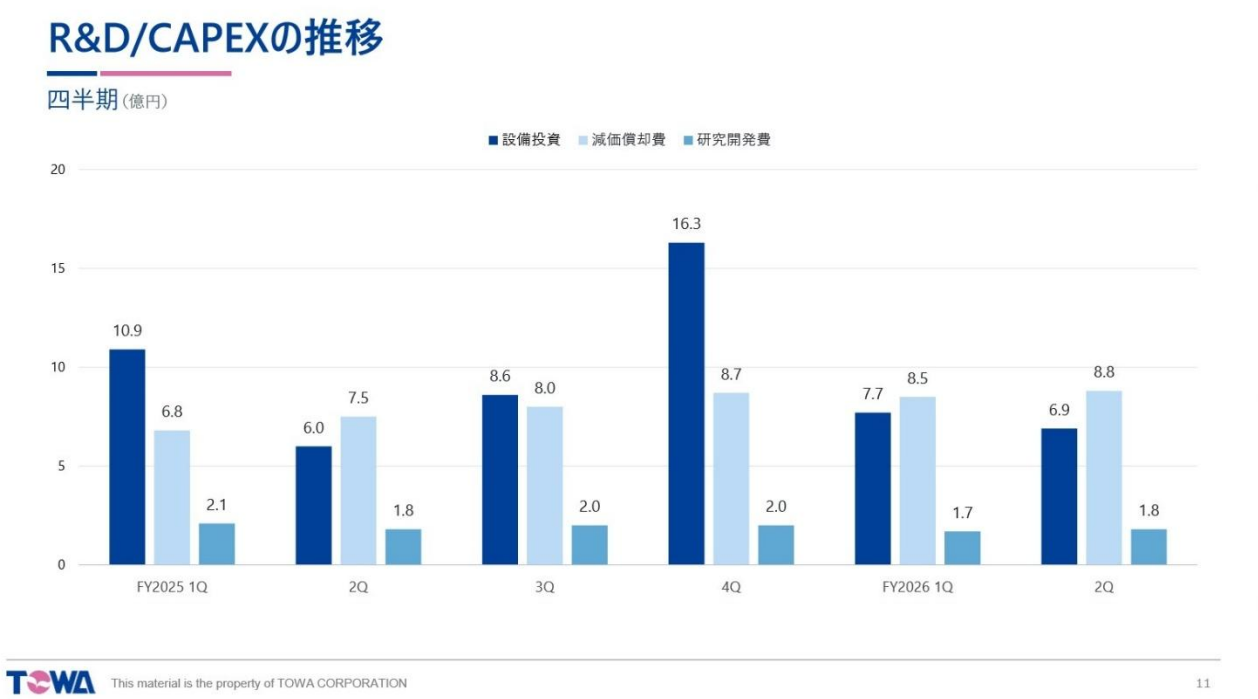
第 2 四半期は中国が 82.8 億円と最も大きく、前四半期から 26.8 億円増加しました。受注と同様に、半導体内製化に向けた設備投資が売上の増加に寄与しています。下期については、高水準の受注残を背景に、その他アジアを中心に売上の拡大を見込んでいます。



続いて、上期の営業利益について前年同期からの増減要因を示したものです。

前年同期の営業利益 24.9 億円に対し、売上高の増加による影響がプラス 46.9 億円となりました。一方、製造原価に含まれる開発費などの増加が 7.6 億円の減益要因となったほか、製品ミックスなどによる影響がプラス 1 億円となり、これらを合わせた売上総利益への影響はプラス 40.4 億円となりました。

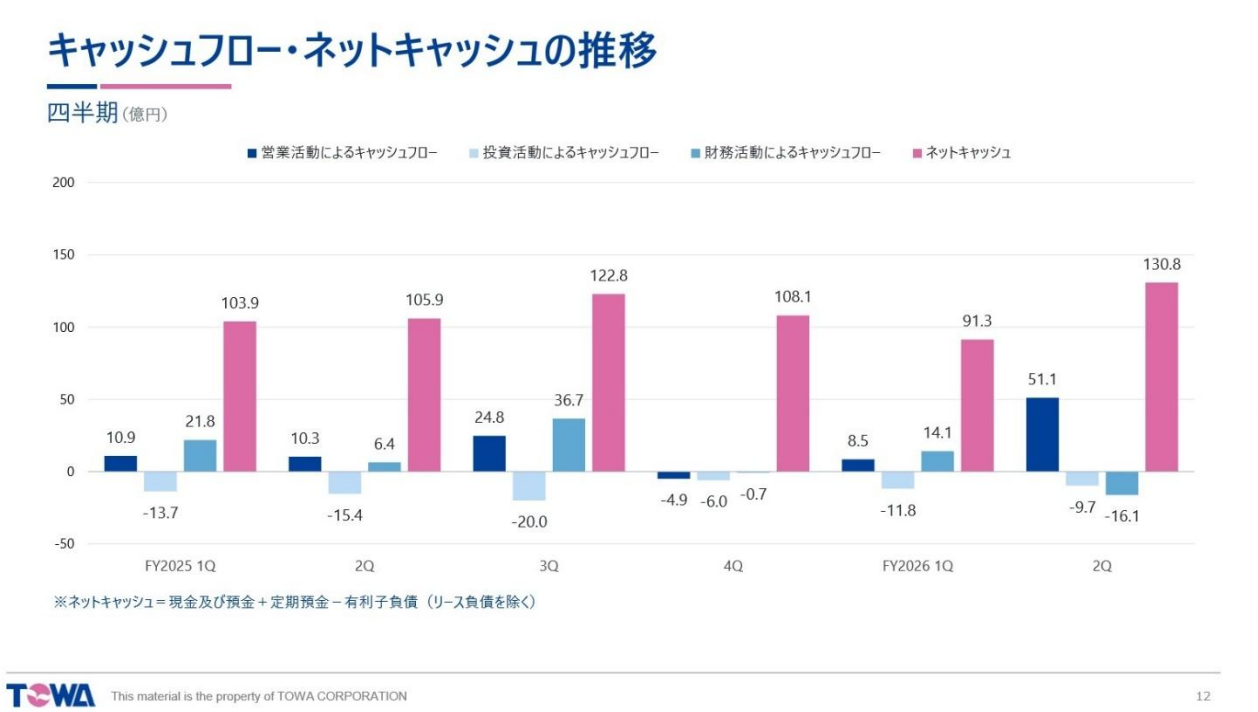
また、販売管理費は、人件費の増加を主因としまして 8.4 億円の減益要因となりました。この結果、営業利益は前年同期比 31.9 億円増の 56.8 億円となりました。



続いて研究開発費、設備投資、減価償却費の四半期推移です。

第 2 四半期の設備投資は 6.9 億円、減価償却費は 8.8 億円、研究開発費は 1.8 億円となりました。設備投資は、生産設備の更新・増強や、スマートファクトリーなどを中心に実施しました。

今後も需要動向を見極めながら、生産体制および開発体制の強化に向けた投資を積極的に進めてまいります。研究開発については、次世代モールディング技術開発を中心に継続して取り組んでいます。



続いてキャッシュフローとネットキャッシュの推移です。

第 2 四半期の営業キャッシュフローは 51.1 億円となりました。利益の計上に加え、運転資金の改善などにより、第 1 四半期から大きく増加しています。投資キャッシュフローはマイナス 9.7 億円、財務キャッシュフローは配当や借入金返済などによりマイナス 16.1 億円となりました。

この結果、9 月末のネットキャッシュは 130.8 億円となりました。今後も成長投資と財務健全性のバランスをとりながら資金を活用してまいります。

司会：続きまして、事業環境および業績予想について三浦よりご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

三浦：それではただいまご説明いたしました決算内容を踏まえまして、事業環境および通期業績予想について、私、三浦よりご説明いたします。

上期は生成 AI 関連に加え、データセンター向けサーバーの電源管理用途など幅広い分野で設備投資が拡大しました。こうした需要を確実に取り込み、受注高・売上高ともに高い水準となっています。ここからは、足元の市場環境、受注拡大に対応する生産体制、そして修正後の通期業績予想について順にご説明いたします。



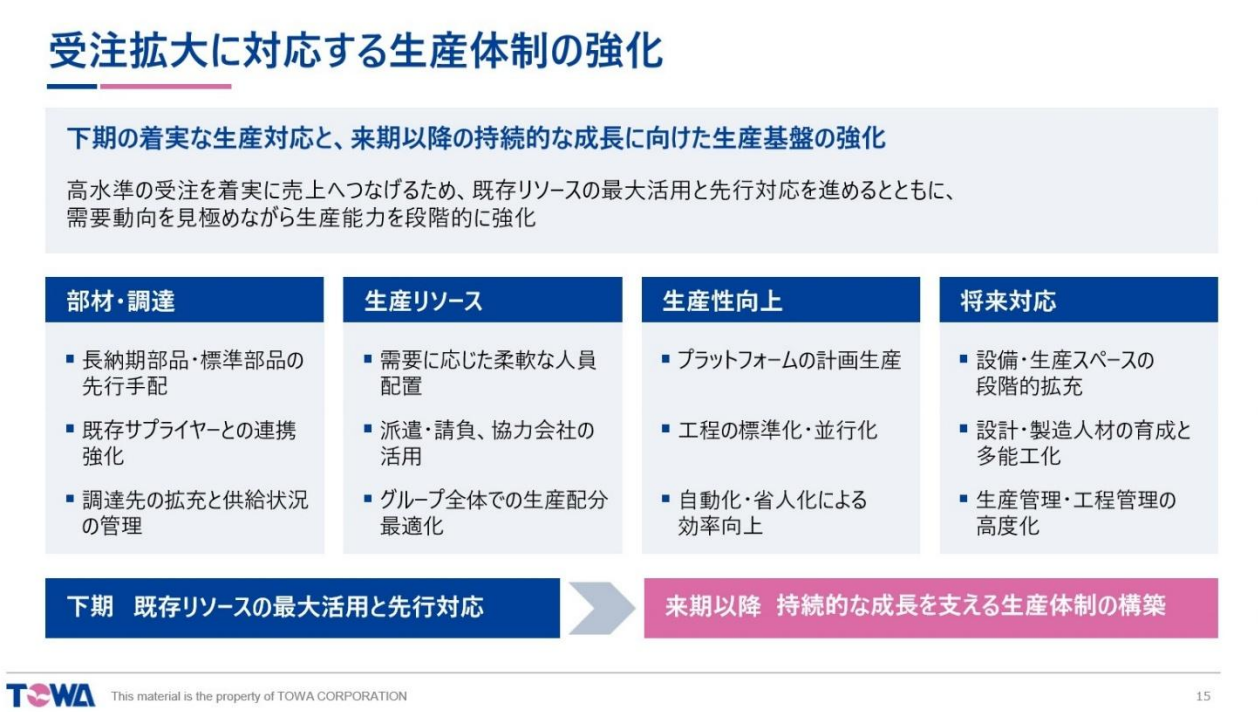
こちらは上期実績と通期見通しのサマリーです。

事業環境につきましては、生成 AI 需要の拡大を背景に、韓国・台湾では主にメモリ関連の設備投資が活発化しています。また、その他アジアでは、データセンター向けサーバーの電源管理用途を中心に設備投資が拡大しています。中国でも半導体の内製化に向けた投資が継続しており、需要は特定の地域や用途に限らず幅広く広がっています。

こうした環境のもと、第 2 四半期の受注高は 329.7 億円となり、第 1 四半期に続いて、四半期として過去最高を更新しました。上期累計の受注高も 547.8 億円、前年比約 2.2 倍と、半期として過去最高となりました。9 月末の受注残高は 518.3 億円まで積み上がっており、今後の売上成長を支える基盤は一段と厚みを増しています。

上期売上高は 337.1 億円、前年比約 1.4 倍となり、半期として過去最高を更新しました。営業利益は 56.8 億円、営業利益率は 16.9%となり、増収効果を中心に前年同期から大幅に改善しました。受注拡大だけではなく受注残を着実に売上へ繋げ、利益改善にも結び付けることができたと評価しています。

これらの上期実績と足元の受注状況を踏まえ、通期業績予想を上方修正しました。下期は高水準の受注残を確実に売上へ繋げ、売上高および各段階利益とも過去最高を目指します。



続いて、受注拡大に対応する生産体制の強化についてご説明いたします。

足元の受注拡大に対応するため、部材調達、生産リソース、生産性の各面からの供給体制を強化します。下期の業績達成に向けた対応と、来期以降の成長を支える基盤整備を並行して進めます。

部材調達面では、長納期部品や標準部品を先行手配するとともに、既存サプライヤーとの連携強化、調達先の拡充を進めています。生産リソースについては、柔軟な人員配置や協力会社の活用に加え、国内外グループ拠点を含めた生産配分の最適化を進めています。

生産性の面では共通プラットフォームを活用した計画生産、工程標準化・並行化・自動化・省人化により、リードタイム短縮と工数削減を図ります。下期は既存リソースを最大限活用し、受注残を着実に売上へ繋げます。来期以降は需要動向を見極めながら、設備・生産スペースを段階的に拡充してまいります。

業績予想

(億円)	FY2025 通期 実績	FY2026 1H 実績	FY2026 2H 予想	FY2026 通期 予想	FY2026 YoY（通期）	FY2026 当初予想 通期 予想
売上高	543.6	337.1	372.8	710.0	+30.6%	640.0
半導体事業	403.9	257.6	278.8	536.4	+32.8%	483.9
└モールディング	365.6	243.3	263.8	507.1	+38.7%	448.9
└シンギュレーション	38.2	14.2	15.0	29.2	-23.5%	35.0
TSS事業	94.7	57.3	58.0	115.3	+21.7%	100.2
メディカルデバイス事業	24.8	13.8	13.0	26.9	+8.2%	25.8
レーザ事業	20.0	8.2	23.0	31.2	+55.7%	29.9
営業利益 営業利益率	69.1 12.7%	56.8 16.9%	74.6 20.0%	131.5 18.5%	+90.1% +5.8pt	102.4 16.0%
経常利益	69.4	52.8	74.6	127.5	+83.5%	102.4
親会社株主に帰属する当期純利益	45.9	38.3	51.6	90.0	+95.9%	70.0

※ TSSは「Total Solution Service」の略称です。

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

こちらは修正後の通期業績予想です。

通期売上高は 710 億円とし、当初予想から 70 億円上方修正しました。前期比 30.6%増となり過去最高を見込んでいます。利益面では、営業利益を 131.5 億円とし、当初予想の 102.4 億円から 29.1 億円上方修正しました。営業利益率は 18.5%を見込んでいます。

経常利益は 127.5 億円、親会社株主に帰属する当期純利益は 90 億円を計画しており、売上高および各段階利益ともに過去最高を更新する見通しです。

下期だけで見ますと、売上高 372.8 億円、営業利益 74.6 億円、営業利益率 20%を計画しています。上期末に積み上がった受注残と足元の良好な受注環境を背景に、生産・調達面での対応を着実に進め、計画した売上の確実な実現と利益確保に繋げてまいります。

一方で、部材の供給状況や案件ごとの納期時期、地政学リスク、事業環境による不確実性も残ります。こうしたリスクを注視しながら着実な業績達成を目指してまいります。



最後に配当についてご説明します。

通期連結業績予想の上方修正を踏まえ、2027 年 3 月期の期末配当予想を、前回予想の 1 株あたり 24 円から 30 円へ 6 円増額します。中間配当は実施していないため、年間配当予想も 1 株当たり 30 円となります。

当社は安定かつ継続的な配当を基本方針としています。その上で業績の状況、将来の事業展開に必要な成長投資、財務基盤の充実などを総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を行ってまいります。今回の増配は、上期実績と通期業績の見通しを踏まえたものです。今後も持続的な利益成長を実現し、企業価値の向上と株主還元の充実に繋げてまいります。

以上で、2027 年 3 月期第 2 四半期の決算説明を終了いたします。

下期は高水準の受注残と良好な受注環境を着実に業績へ繋げ、通期計画の達成を目指してまいります。また、その先の成長も見据え、引き続き収益性の向上に取り組み、持続的な企業価値向上に繋げてまいります。

本日はお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

司会：ありがとうございました。

質疑応答

司会 [M]：それではただいまから質疑応答に移らせていただきます。

最初のご質問です。氏原様、よろしくお願いいたします。

氏原様 [M]：三浦社長、中西様、日頃いつもお世話になっております。

三浦 [M]：お世話になっております。

氏原様 [Q]：嬉しい上方修正をありがとうございます。二つの質問をしたいと思います。まず一つ目、詳細はちょっとお話しづらいと思いますが、韓国の受注についてです。

いただいた資料によりますと、第 1 クォーターが 13 億 8,400 万で、第 2 クォーターが 45 億 1,700 万、この 45 億というのは、23 年の 7-9 の 3 カ月で 44 億という数字があって、久しぶりですね。

それで質問としましては、先ほど冒頭中西さんと三浦さんからメモリ関係だよとお話をいただいたんですけど、いわゆる MUF の用途なのか。あと私が御社をカバレッジしていて、ほとんどの投資家から反発を食らうのが、氏原さん、もうハイブリッドボンディングになったら MUF は使わなくなりますよということで、韓国でのメモリのポテンシャルってどうなのという、結構アゲインストのオピニオンが多いんです。その辺について三浦社長のご見解を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

三浦 [A]：ありがとうございます。まず韓国のメモリ需要の件ですが、当初、23 年ですかね、大量に HBM 向けの装置の受注をいただきました。ただその後、生産がそれほど伸びないと。その伸びない背景が、需要がないのではなく、やはりメモリ、HBM になったら多段になります。多段になるとチップの量が足りないというところで、相当お客様はチップの Fab への投資を強化しておられました。

かつ、HBM の数が足りてないというところで、お客様としてももっと増産をしたいんですが、Fab というか、チップが出てこないというところで、ずっと後工程への投資が全くされてこなかった事実がございます。

今回、今期初めて受注を含めて上がってきたのが、Fab からやっと安定したチップの量が出てきたというところで、お客様のほうも後工程用の工場を建設したり、増床したり、増築したりと、やっとわれわれの後工程、組み立てるほうにも、今、注文が入りだした状況でございます。

メインは基本的には MUF ですが、われわれの設備は MUF のみならず、ほかの CoWoS 含めてそういったところも生産できますので、100%MUF ではないんですが、MUF がメインで、ほかのものも作るという受注を、今、現状いただいております。

氏原様 [Q]：ありがとうございます。ハイブリッドについてはどうでしょうか。

三浦 [A]：ハイブリッドに関しましては、いろいろなご議論があるかと思うんですが、現状われわれがお客様からつかんでいる情報としましては、全く HBM が足りてない。当然のことながらデータセンター向けのみならず、エージェント AI 向け、ロボットとかそういったものにも HBM が要るというところで、全く足りてない。

今、お客様はどちらかというと、新しいことを考えて投資して評価して時間かけるより、今あるものを大量に作っていきたいという方向がある。これはお客様が今後どういう形で具体的に動いていかれるかですが、これ以上 MUF のギャップを詰めることが非常に困難、当然材料代も高くなってくる、歩留まりも悪くなってくるところで、高さ制限がある中で、そういった高さ制限を緩和して、若干厚みが増えても同じ機能で数を作っていきたいという動きもございます。

ハイブリッドボンディングに関しては、われわれがお客さんから聞いて感じているのは、本当にもう組み立て工程で無理だとなれば、ハイブリッドボンディング、当然組み立て工程でやっているわれわれの MR MUF より相当高価な設備であり、現状、技術的な課題も非常に厳しいと聞いております。できないとなればそちらに行かれると思うんですが、今の数が足りないとか、もう早急に物を作らないとという中では、まだハイブリッドボンディングが出てきたから、われわれの設備需要が減っていくということは、お客様からは感じていない状況でございます。

氏原様 [Q]：分かりました。ご丁寧にありがとうございます。二つ目です。社長、前回は 23 年の 7-9 で 1 回受注が落ちたんですね。社長がおっしゃるように、お客様のほうのチップが出てこないから、それは要らないよねということです。

今回この第 2 クォーターで 45 億ですけど、クォーター別では分かりませんが、追加的なご受注の可能性は十分あると考えてよろしいんでしょうか。一旦ここでピークなのかなとか、その辺の受注のモメンタムの続き具合はいかがでしょうか。

三浦 [A]：先ほど申し上げましたが、やはりお客様の工場というか、組み立てをするスペースがあるかないかなんですが、現状ではまだ建設途中のものもございますし、韓国のメーカーさんではアメリカのほうも、今、相当大きな工場を建てられております。そういったところも踏まえると、まだまだ工場ができていく限り、納入する台数は、受注を含めて継続していくものと見ております。

氏原様 [Q]：分かりました。最後 3 問目にします。

社長は先ほど来データセンターの電源管理用途というお言葉なので、私たちの言葉にすると、パワー半導体用のモールディングかなという感触を持っています。

うちの化学セクターの担当者が、化学系メーカーのカバレッジをさせていただいていて、同社の方とのお話をさせていただいたんですけど、持ってらっしゃる温度感が、御社のモールディング装置のほうの受注にようやく入ってきたかなという感触を持っていてよろしいですか。

三浦 [A]：化学系メーカーとのビジネスの関係を現段階ではあまりよく把握していませんので分からないんですけども、今急激に伸びてきたのがやはり電源。選挙を巡っていろいろな見方があり、中間選挙の結果によっては、データセンターの件数が減ってくるのではないかという話もありますが、今のところわれわれとしては止まっていないのと、当然電力問題等々もございますので、やはりパワーマネジメントをする IC が非常に必要になってくるというところ。

プラス、当然われわれで言いますディスクリート関係、電流の整流とかをコントロールする、ディスクリート関係、小さなアナログのパッケージになるんですけども、こういったものも例えばざっくりと、データセンター用の GPU のオン・サブストレートには 500 個ぐらい要るというところで、その掛け算で相当そちらの需要も増えてきています。

あと、先ほど申し上げようとしましたエージェント AI、データセンターだけでなく、エージェント AI の需要が非常にこれも伸びてきております。

そういったところを踏まえて、今、データセンター用途に集中しているとは聞いているんですけども、全体的に、毎年同じことを言っているんですが、AI 関連の半導体需要が非常に今増えてきたというところでございます。

氏原様 [M]：分かりました。ありがとうございました。

三浦 [M]：ありがとうございました。

司会 [M]：氏原様、ありがとうございました。続いてのご質問です。島本様、よろしくお願いいたします。

島本様 [Q]：私から 3 点ご質問させていただきたいです。

一つ目が、先ほどの氏原さんの質問にあった HBM のところで、1Q の決算の後の取材では、MUF を採用されている会社さんの当面大きな HBM 関連の発注はないんじゃないかというお話をお聞きしておって、これがもし認識として間違っているのであれば、そんなことないということで結構で

すけれども。そのあたり何か、このセカンドクォーターで動きに変化が出てきたのか、まず一つ目、確認させてください。

三浦 [A]：先ほどお話しさせてもらいましたように、やはりお客様側に設備を受け入れる工場がないというところでお客様からの発注が全くなかったんですけども、ここに来て韓国メーカーのみならずアメリカ系、皆さんがやはり 2027 年から HBM を量産していく計画で工場を建てられておりました。そういった背景がございまして、この HBM の需要が伸びてきている状況でございます。

島本様 [Q]：フォローアップで、昨今 HBM のディスペックの話が結構話題になっているんですけれども、12 層から 8 層に来年の製品をするんじゃないかという話ですが、それは御社の受注と関係あると見たほうがいいですかね。これはいかがですか。

三浦 [A]：たとえばディスペックされたところで、われわれの金型設備は変わらないので。ただそういう意味で、先ほど申し上げましたように、やはり絶対的に数が足りてないので、スペックダウンしてでも作らないといけないという流れが無きにしもあらずです。そういったところで生産量を増やす上で、需要が伸びているところは感じております。

島本様 [Q]：分かりました。ありがとうございます。二つ目が受注、非常に強いセカンドクォーター、おめでとうございます。3Q 以降の見方ですね。もう既に見通し出されなくなったとは承知しているんですが、できれば下期さらに上がる余地があるのか、それとも 2Q さすがに強かったので、一旦ちょっと落ち着くような見え方にされているのか、今の三浦社長の感触を教えていただけないでしょうか。

三浦 [A]：今のところは止まる気配がない状況でございます。ただわれわれも先のことが分からないとは言ってはいられないんですけども、やはりクォーター、クォーターできっちりした、確実というか、可能性の高い受注売上計画を取っていくというところで動いておるんですが、今のところ来期含めて止まる気配がない状況でございます。

島本様 [Q]：分かりました。ありがとうございます。あと 3 点目、キャパシティのところでして、もう既に今の注残からすると相当生産が逼迫した状態なのかなとお見受けします。

資料でも書いてはあるんですが、例えば来年どれだけのキャパを増やす余地があるかですとか、あとは新工場とかそういった、ほかの蘇州とかでもスペースに倉庫の部分を変えるとか、何かそういう具体的な話がそれほど多くはない感じも受けているんですけれども。そのあたり、生産、来年のキャパどれだけ増やせるかと、具体的な何か用地の施策とか、そういった話がもう一段踏み込んでお話しいただけないでしょうか。以上です。

三浦 [A]：われわれ 2032 年に売上高 1,000 億円という目標を中長期計画で立てておりまして、それに伴って、投資も含めて、全て毎年必要な投資を行っております。現状の受注状況を踏まえましても、この量であれば現行のキャパで全く問題なく生産できる状況です。投資に関しましては、われわれの計画通りの投資を継続していくというところで、急にこの投資額を変えてやっていかないといけないという状況ではございません。

ただ問題としましては、やはりわれわれ加工品、内製品に関しては当然今もお話ししましたように金型含めてキャパはあるんですが、問題はやはり購入品ですね。モーターとかセンサー、われわれのみならず、前工程さん、ほかの工程の方たちもすごく困っておられると思うんですが、購入品の納期が非常に伸びているというところで、今われわれもこのあたりの安定した供給をいただけるように、調達のほうで頑張って動いているところでございます。

島本様 [Q]：ありがとうございます。1 点フォローアップで、2032 年の 1,000 億を長期のキャパの計画として、今、それを例えば前倒しするとか、そういう考え方は、今のところはそれほどないということでしょうか。四半期 300 億の受注とかが入って。

三浦 [A]：1,000 億円狙うというところですが、キャパもわれわれとしては、1,000 億円だから 1,000 億円のキャパではなく、若干のプラスの余裕を見たい。余裕を見てやっていかないと 100%稼働するというのは非常に難しいです。

先ほど言いましたように、5 年先の予測は非常に難しいですけれど、こういった推移の中でいろんな計算をしまして、上振れしても、今のままでいける範囲で計画通りの投資をしていこうと考えております。ただ本当に突発的にさらに増えていくということになれば、そのあたりの投資方針も検討していくつもりではございます。

島本様 [M]：分かりました。一旦私から以上にします。ありがとうございました。

三浦 [M]：ありがとうございます。

司会 [M]：島本様、ありがとうございました。続いてのご質問です。ナカノミョウ様、よろしくお願いいたします。

中名生様 [M]：ジェフリーズ証券の中名生と申します。よろしくお願いいたします。

三浦 [M]：お世話になっております。よろしくお願いします。

中名生様 [Q]：似たような質問で恐縮ですけれど、以前 HBM 向けは今後数年間、年間十数台ぐらいの需要が見込まれるというお話をされていたと思いますが、その規模感は変わって引き上げられてきている感じでしょうか。

三浦 [A]：元々、今まで 1 社さんがメインだったんですが、先ほど申し上げましたように、他社さんも認証が得られて供給していかれます。エージェント AI 向けも非常に旺盛な需要になってきていますので、今までのボリュームと比べまして 1.5 倍から 2 倍ぐらいの量になってくるという状況でございます。

中名生様 [Q]：そういう意味では、年間 20 台ぐらいのレベルもあり得る。

三浦 [A]：そうです。あとは工場建設次第だと思います。

中名生様 [Q]：汎用メモリも需要が強いと思うんですけど、その辺少し足元の状況とこれからの見通しをお願いできますでしょうか。

三浦 [A]：汎用メモリにおいて、携帯電話などの価格が非常に高くなっていると思いますが、やはり一番需要が高いのは HBM ということで、単価が高いため、メモリメーカーさんはチップを HBM に集中させて、汎用メモリを全く作らなかったという経緯があると認識しております。

ただここに来て、Fab の増強も終わり、汎用メモリ向けのチップの需要も出てきたというところで、われわれも長らく汎用メモリ向けの当社コンプレッション装置の受注が低迷していましたが、特に昨年ぐらいから、汎用メモリの需要も急増してきておりまして、今後も伸びていくかと思っております。

中名生様 [Q]：NAND に関してはいかがでしょうか。

三浦 [A]：NAND も同じく、今、高性能 NAND の開発や試作も並行して進めておられますので、通常 NAND プラス高性能向け NAND も、増えてくるかと思っております。

中名生様 [Q]：2Q の受注はマレーシアがすごく増えておりますが、下期はどう見ればいいでしょうか。

三浦 [A]：当社は、生産・製造を行う会社ですから、生産を平準化するため、先々の需要やフォーキャストを確認しています。ただ、現在いただいている受注は、エンドユーザー様から発注を受けて、いくら生産して納めないといけないという計算を基に、来年の中頃から量産を開始する案件に対して、設備発注を急に受けた状態となっております。

ただ、聞いておりますと、年間計画のみならず、半年後の計画が突発的に出てきたのですが、来年になれば、来年初旬もしくは中頃になれば、また半年後か 1 年先のフォーキャストが出てくると思いますので、現状は、おそらく止まる気配がないのではないかという見方をしております。

中名生様 [Q]：今、リードタイムはどのくらいでしょうか。

三浦 [A]：設備によって長短がありますが、これまで大体半年とアナウンスさせていただいておりましたが、現状、1 年を超えている状況としてお客様とはお話をさせていただいております。

中名生様 [M]：以上です。ありがとうございました。

三浦 [M]：ありがとうございました。

司会 [M]：中名生様、ご質問ありがとうございました。続いてのご質問です。ハセガワ様、よろしくお願いいたします。

長谷川様 [M]：モルガン・スタンレー証券の長谷川です。よろしくお願いいたします。

三浦 [M]：よろしくお願いします。

長谷川様 [Q]：利益率の件について解説いただきたいと思います。上期、1Q から 2Q にかけての変化、それから下期の想定ですね。粗利は分からないですが、OP マージンで 20%まで上がってくる想定になっています。

これはおそらく先ほどある MUF の部分が、コンプレッションの装置が寄与してくるので上がるのかなという想像をしているんですが、部材コストの上昇、それから価格の変化、そして期初の段階ですと、PLP とかの先行、いわゆる開発品ですね。結構コストが先行するというか採算性が先行している他社に合わせないといけないのでとか、いろんなことで利益率が低い案件もあるという話もありました。

この利益率の 1Q から 2Q の変化、それから下期の想定の変化について解説いただけますでしょうか。

中西 [A]：私から説明させていただきます。上期の営業利益が 56.8 億であったものが下期の営業利益は 74.6 億と見ておるところでございます。一つの内訳としましては、売上の増加、増収要因が 16.4 億を見ておりまして、それ以外の製品ミックスで 1 億ほど見ているといったところになります。

それから、開発費などの減少による影響としては 1.7 億と、粗利への影響額としては 19.2 億のプラスを見ております。

それから販管費につきましては、人件費の増加等々で 1.4 億のマイナスとなり、営業利益は 74.6 億、17.7 億増益効果が見込めるという見方をしておるところでございます。

長谷川様 [Q]：開発費の影響は上半期で大体終わる、一巡する感じですか。

中西 [A]：そうですね。おっしゃっていただいたように、立ち上げのところは費用がかかっておりましたけれども、標準化とか、手慣れてきた部分がございますので、若干そこは剥落していい形で進んでおるということです。

長谷川様 [Q]：分かりました。それから、今の項目にはなかったんですが、資材、購入製品の価格上昇は結構あるのではないか。最近モーターの話もありましたが、あるいはマグネットが上がっていたりするので、値段交渉してきていると思いますが、あとプリント基板とかも結構勢いよく上がっている感じもしております。

そういった調達品の価格上昇の影響はどのぐらいあって、それは製品に乗せていけるのか、それともいわゆる稼働益とか何かで吸収していくのか、そのあたりの考え方を教えてください。

中西 [A]：具体的に、数字でこれだけ上昇するという見方はしておりませんで、そこは部材の種類といいますか、調達先を変えるとか、組み合わせを変えるということで吸収していこうと考えております。

それと、部材も上がっておるんですけども、われわれの販売価格もこういった需要の状況で交渉がしやすい状況も生まれてきておりますので、そういった点で販売価格を上昇させて、部材の値上がりについては吸収可能な状況になりつつあると考えております。

長谷川様 [Q]：分かりました。ありがとうございます。そうしますと、来期以降の考え方になります。部材価格の上昇と、それから価格のほうも、今ですと半年、1 年先ですので、来年度の話がいよいよ始まってきています。今期と比べると、かなり交易条件的には良好な手応えになっているという理解でよろしいでしょうか。

中西 [A]：そうですね。足元いろいろな試みは、価格交渉ですとか原材料、原価コストの引き下げとかやってきたのですけど、それが形となって来期以降ようやく、大きくではないですけど、徐々に姿を現して成果に繋がってくれると思っております。

長谷川様 [Q]：ありがとうございます。それから先ほど電源関係のお話です。データセンターの電源周りの話。いわゆる既存のような製品も大量に生産量を増やしたい、そういうオーダーという理解でいいですか。

三浦 [A]：そうですね。既存というか今後含めて、今問題点は電源、電力も足りないなど、高性能になってきますと放熱の問題が出てきます。既存製品も増えているのですが、今後、すでに受注も始まっておりますが、磁性体ですね。放熱性のいい樹脂を使うようなパワー半導体なども、非常に増えてきております。

ただそれを作るには、従来のトランスファー工法ではできないというところで、われわれのコンプレッション装置でしか対応できない領域が確立されてきており、そういったものを踏まえて今増えてきております。

長谷川様 [Q]：分かりました。ありがとうございます。それから生産能力のお話で、スライドでは15 番のところで、生産スペースの段階的な拡大などの話がありました。

単純に、スペースを広げて、組立能力、同じ工数でやるということは多分考えてらっしゃらないと思うので、海外の蘇州とかマレーシアとか、大きなスペースもありますけど、いかにこれを効率よく、同じスペースでなるべく最大限の価値を生みたいと考えてらっしゃるんだと思います。そのあたり生産能力、いわゆるお客さんへの供給能力をどうやって増やしていくのか、その中でこういったスペースの拡大はどういったところを指しているのかについて、もう少し解説いただけないでしょうか。

三浦 [A]： 2032 年に 1,000 億円という目標を立てまして、計画通り投資を行ってキャパを増やしてきておりました。

その中で、本当に足りなければ新しい工場などを考えないといけないのですが、お話がありましたように、特に中国工場に関しましては、まだスペース、敷地が余っていますので、計画通り、その敷地内で工場を増床し、売上が上がる分、生産台数も増えてくるという計画の中で、投資を行い、増産をしていく状況でございます。

長谷川様 [Q]：そこら辺までやれば、例えばモールド装置周りですと、年間大体月 50 億は余裕で回せる。蘇州工場のところをやれば、月例えば 60 億とか、もうちょっといけるんですか。

三浦 [A]：そうですね。現状でも可能です。先ほども中西からの説明でありましたように、シンギュレーション、こちらも相当受注が増えてきております。シンギュレーションのブレード関係というのは、中国での需要が非常に多いものですから、どちらかというとブレードも作らないといけない状況でございます。

長谷川様 [Q]：ありがとうございます。それから最後ちょっと INNOMS のその後の進展とか何かアップデートあれば教えてください。

三浦 [A]：INNOMS に関しましては、お客様でフィールド評価中でございます。特に大きな問題が出ているわけではなく、期間をかけて、それが量産に使えるかどうかという確認をしている状況でございます。早ければ来年 4 月から、ほかのメモリなどのお客様にも販売開始ができるという状況で、今のところ評価を進めております。

長谷川様 [Q]：だからうまくはまると本当に中国のメモリ投資のところもかなりいただけそうな雰囲気でしょうか。

三浦 [A]：はい、INNOMS については新聞発表をさせてもらいましたので、中国からも、すぐに持ってきてほしいという話もあるんですが、まだ評価中でございますので、うまくいった暁には、中国にも納入できると思っております。

長谷川様 [M]：分かりました。ありがとうございます。私からは以上です。

三浦 [M]：ありがとうございました。

司会 [M]：長谷川様、ありがとうございました。それでは楠木様、よろしくお願いいたします。

楠木様 [Q]：お世話になります。LMR の楠木と申します。ありがとうございます。私からは 1 点だけ、生産能力の考え方についてです。

私の記憶が正しければ、御社は確かもともと中計で、28 年 3 月期に 710 億円の売上高という目標を掲げていて、今回偶然か分からないですけど、今期の売上高を 710 億円に引き上げられたと思います。

先ほど幾つか数字があったんですけれども、端的に聞くと、来期はどれくらい計上できるのか。例えば今の受注水準でいうとどうでしょう。ならすと、200 億円とか四半期で受注が続いたら、掛ける 4 をすると 800 なので、800 は来期行けるのか。でも 250 だとしたら 4 掛けたらもう来期 1,000 億円になるのか、その辺の何かご感触いかがでしょうか。

三浦 [A]：先の受注予測を確定するのが非常に難しい状況ですが、今の環境が続くとなりますと、おそらく、今期の実績から 2 割程度、低めに見積もっても 10%程度上になるのではないかと考えておりますので、800 億円ぐらいになってくるかと思います。

ただ今お話しがありましたように、本当にまだこの需要がさらに増えた場合は、1,000 億円になるとか、そんな状況をいろいろ想定しております。生産キャパに関しましては、そういったところです。

当然内部での製作に関しましても先ほど言いましたように、われわれとしては中長期計画を基に、今、計画通り進めておりますが、協力メーカーさんもございます。キャパが逼迫したときには、協力メーカーさんにお願いして、いろいろ助けてもらう体制も整えておりますので、直近 1、2 年の上振れも含めて、何とか対応できるキャパがある計算はしております。

楠木様 [M]：分かりました。ありがとうございます。以上です。

三浦 [M]：ありがとうございます。

司会 [M]：楠木様、ありがとうございました。では島本様、よろしくお願いいたします。

島本様 [Q]：2 度目で恐縮です。

キャパシティのところを改めて確認したいのが、投資家さんも多分皆さん思われているんですけど、現状で既に 300 億の受注が取れていて、次四半期以降も受注が大きく落ちるとは、現時点では想定していないと仮定すると、もう年間で 1,200 とか、四半期で 300 が続けば行くわけですので、何かそれで 1,000 はまだまだ遠いみたいな感じで来期見られるのが、相当ギャップがあるような印象を持っております。

今、御社の取れている受注が、リードタイムが長期化で、タイミング、納期がだいぶ先のものが先行的にかなり入ってきているので、来期の売上として、それほど納期を急ぐ案件が少ないという理解でよろしいでしょうか。

三浦 [A]：社内製作に関しましては、今瞬間風速的なものが入っておりますが、先ほど言いましたように、協力メーカーさんを踏まえて、1,000 億ぐらいができるようなキャパはもう来期であればございます。

ただやはり購入品が、もう 1 年以上のものとかが増えてきております。これが入ってくれば作れるのですけども、入らなければ作れない状況ですので、どちらかというと、今の課題は調達のほうになっております。

島本様 [M]：分かりました。大変クリアになりました。ありがとうございました。

三浦 [M]：ありがとうございます。

司会 [M]：島本様、ありがとうございました。福山様、よろしくお願いいたします。

福山様 [M]：大和証券の福山と申します。

三浦 [M]：お世話になります。よろしくお願いします。

福山様 [Q]：よろしくお願いします。HBM の台数の見通しが年間 20 台ぐらいということで、前回よりもトーンが上がっている背景を改めて確認したいです。

これはデバイスメーカーがスペックを、いわゆるレイヤー数を落とすことによって数を増やすというトレンドになったことによって、モールディング装置の重要性が高まったから引き上げられているのか。それともお客さんのサイト、スペースの確保が前倒しで準備ができているから引き上げら

れているのか。この引き上げの要因分解として何が一番重要なファクターで、見通しの引き上げに最も効いているのかを教えてほしいです。

三浦 [A]：まずやはり、今までチップが出てこなかったというところで、後工程の工場も建てられなかった。ただもう去年ぐらいからチップの量が出てきたというところで、お客様も組立工場の建築を行いまして、完了してきたというところで、その量が増えてきております。

もう一つが、今まで 1 社 1 強だったものが、27 年からほかの大きな二つのメモリメーカー様も工場を建てられて増産していくと、その需要もプラスで増えてきている状況でございます。

福山様 [Q]：なるほど。じゃあ、HBM のレイヤーが 12 層から 8 層になって、ロジック・ダイが増えている、何かモールディング装置の重要性も、プロセスも増えるのかなとか思ったんですけれど、そういうファクターとかではない。

三浦 [A]：それは多分これからだと思いますね。

福山様 [Q]：それはこれからの話。

三浦 [A]：いずれにしても、現状の生産量でも全く数が足りてない。そういったところから、とにかく、スペックダウンしてでも作ろうと、そういった動きはあるものの、まず今われわれはやはりアッセンブリーする工場がないというところで、工場ができたから受注が増えたというところがやはり大きなファクターとなっております。

福山様 [M]：分かりました。ありがとうございました。

三浦 [M]：ありがとうございます。

司会 [M]：福山様、ありがとうございました。ほか、ご質問よろしいでしょうか。それでは、ご質問も出尽くしたようなので、これにて質疑応答は終了させていただきたいと思います。

本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。これをもちまして、TOWA 株式会社 2027 年 3 月期第 2 四半期決算説明会を終了いたします。ありがとうございました。

［了］

脚注

1. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す

注記

1. 当資料は、SCRIPTS Asia 株式会社によって録音・書き起こしされたものを当社にて一部編集したものです。
2. 年間の会計期間である 4 月～翌年 3 月までを FY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は 4-6 月を 1Q、7-9 月を 2Q、10-12 月を 3Q、1-3 月を 4Q と表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。%は実際の金額を基に算出し四捨五入しています。

将来事象に関する注意事項

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。

また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがいまして、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。